



Editorial

Chers lecteurs/lectrices,

Nous avons passé un moment intense avec MiNaPAD 2023 en accueillant plus de 200 personnes ; cela nous prépare progressivement à l'organisation de EMPC 2025 !

Donc cette fin de premier semestre est satisfaisante pour l'association et je vous en remercie tous ; la pause estivale est méritée !

Mais la rentrée va être intense et nous allons avoir besoin de vous pour participer :

- Au programme POWER 2023, il nous faut des résumés
- Au programme THERMAL 2024
- Au programme européen Pack4EU, Sanae Boulay nous fera une description à la prochaine édition,
- A la préparation de EMPC 2025, c'est un MiNaPAD x2

Ainsi, nous travaillons sur la fiche de poste pour un responsable événementiel soit un mi-temps ou bien un alternant afin de nous aider pour ces 2 prochaines années. Cette fiche sera partagée aux adhérents d'ici Septembre.

Comme vous le lisez cela va bouger et il y a de l'activité ; je fais un appel officiel à candidature pour venir rejoindre les membres du comité directeur dont la réunion annuelle se déroulera le jeudi 21 Septembre.

"Everything in electronics between the chip and the system" (ISHM – Une définition du Packaging)

Alexandre VAL

Prochaine édition : Octobre 2023

Un mot du trésorier,

Comme chaque adhérent pourra le vérifier lors de l'Assemblée Générale, le comité directeur de l'IMAPS, terme ambitieux désignant quelques bénévoles issus du monde de l'entreprise, s'attache à maintenir la bonne santé financière de l'association et à constituer des réserves pour à terme financer l'embauche d'un successeur à notre chère Florence partie à la retraite en 2021 au terme d'une année et demie très difficile due au Covid-19.

Ces réserves sont patiemment constituées par les nécessaires marges dégagées sur nos 3 événements, MINAPAD, POWER, THERMAL sans oublier dans une mesure plus modeste mais nécessaire elle-aussi le montant cumulé des adhésions. Notre quadrature du cercle passe par trouver de quoi payer le salaire d'un employé, charges patronales comprises, de quoi payer les réservations d'hôtel, de salles de conférences et de traiteurs dans un contexte post-covid inflationniste, sans verser dans un luxe indécent mais dans le souci de garder un certain standing, de maintenir un site web et quelques logiciels (comptabilité) nécessaires au fonctionnement de l'association. Si le recours de plus en plus fréquent au sponsoring de nos événements nous apporte une bouffée d'oxygène, nous sommes en permanence sur la corde raide, exercice difficile mais qui a le mérite de maintenir le comité directeur à niveau en matière d'économie d'entreprise.

Jean-Yves Soulier

Comité Directeur 21 Septembre 2023
Assemblée Générale 28 Septembre 2023
14^{ème} From Nano to Macro Power Electronics & Packaging Workshop POWER2023 30 Novembre 2023 – Tours

Review from the Chapters of IMAPS- Europe



Dear Microelectronics and Packaging Professional,

11th-14th September 2023 in Cambridge, England

Headed by eminent Keynotes, the Programme comprising parallel Technical Sessions of slide and poster oral presentations, EMPC-2023 is a must for engineers and scientists to keep at the forefront of microelectronics technologies. Excellent Papers accepted by leading international referees are scheduled to be presented at the Conference Sessions comprising: *Advanced Packaging Technologies, Performance and Reliability, Design & Process Optimisation, Markets and Developments, Semiconductor Industry Trends, Applications, System Integration, Innovative Materials, Design and Test,*

The exhibition of major companies at EMPC-2023 showing their innovative equipment, techniques and services to benefit your organisation

[Exhibition | EMPC 2023](#)

Informative short courses preceding the conference provide the opportunity to learn and progress your professional development

[Short Courses | EMPC 2023](#)

Set in Historic Cambridge – the centre for scientific excellence and innovation

[Where else should you be - in September 2023??](#)



The Welcome Genome Campus

Accommodation and travel: There are excellent places to stay, some with easy shuttles to and from the conference. Plenty of choice [Accommodation | EMPC 2023](#)

So, click on <https://www.empc2023.org/>, register now and attend this great event.

The IMAPS-Europe team

10ème Forum MiNaPAD 2023

7 et 8 Juin
WTC Grenoble

Rétrospectives



Alexandre m'avait confié de « revenir aux affaires » d'IMAPS en me nommant chairman de MiNaPAD cette année. Cela a été pour moi l'occasion de faire un bilan sur la 10^{ème} édition de cet évènement, que nous avons, je le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints depuis, **créé en 2011** afin de répondre aux exigences du monde moderne, et face à l'érosion des « forums Interconnex » que nous organisions jusqu'alors

- Passage à la **langue anglaise** afin de nous ouvrir à l'international (accueil de stands internationaux, de présentateurs et d'auditeurs internationaux),
- Dans un **lieu unique (Grenoble)** et avec un nom reconnaissable (MiNaPAD). Bref, création d'une « marque » pour un évènement à récurrence annuelle,
- Pour un évènement généraliste sur le design et la fabrication des micro-technologies de **l'industrie du packaging** des semiconducteurs

12 ans après, notre évènement est toujours en place, et a même atteint une affluence record cette année avec 212 participants qui comprennent à la fois les auditeurs, les présentateurs et les exposants.



Une partie de l'équipe MiNaPAD

Au programme cette année, nous avons une trentaine de présentations techniques en sessions

parallèles, 2 présentations invitées « keynote » de **Laurent Hérard de STMicroelectronics** et de **Pascal Oberndorff de NXP Semiconductors** en session plénière, et une table ronde sur les enjeux de la réindustrialisation du packaging des semiconducteurs en Europe dans le contexte du Chips Act de l'Union Européenne.

Les retours directs que nous avons reçus des visiteurs et des exposants sont globalement **très positifs** :

- Bonne qualité des présentations techniques
- Bonne circulation autour des stands du salon avec interactions riches.

Par ailleurs, la restauration est aussi reconnue de bonne qualité : outre les nombreuses pauses-café qui émaillaient la conférence et permettaient au salon de vivre plus intensément, les buffets étaient appréciés, tout comme l'a été notre dîner de gala **au château de la Commanderie**.



Accueil par trois musiciens



Une table 100% CEA

Mais voilà, si tout cela est encourageant, la situation de notre évènement annuel majeur reste fragile, et je m'en voudrais de trop verser dans la complaisance sans vous faire part des points sensibles pour lesquels l'aide de vous tous me semble indispensable.

Tout d'abord, si l'ouverture à l'international est satisfaisante du point de vue des exposants et des

présentateurs, il n'en va pas de même pour les auditeurs, encore très majoritairement français. Si les belges et les suisses francophones, voire quelques néerlandais se plaisent à venir à MiNaPAD, rares sont les allemands, les britanniques ou les italiens et espagnols à faire le déplacement.

Comment mieux faire rayonner la microélectronique française et attirer plus de visiteurs étrangers ? Vos conseils et votre aide à promouvoir l'évènement auprès de vos fournisseurs, partenaires et clients internationaux sont les bienvenus.

Nous vivons dans une industrie très mondialisée, pourquoi n'en serait-il pas de même de notre évènement annuel phare ?

Maintenant, si nous nous penchons sur notre programme, par ailleurs apprécié, il apparaît que la moitié de nos présentations techniques émanait de seulement 3 sociétés : **STMicroelectronics, CEA-LETI et ASE Group.**

La moitié ! 14 présentations sur 29 !!! Par ailleurs, il s'agit là des **3 sponsors de notre évènement.** Alors, un grand merci à ces 3 sociétés, sans l'apport desquelles, MiNaPAD 2023 n'aurait finalement été qu'une pâle copie de ce qu'il a été. Nous retrouvons aussi ces 3 sociétés largement représentées au comité technique et dans l'organisation de l'évènement. Mais au risque de déplaire à certains, notre industrie française en particulier mérite un rayonnement plus large.



L'équipe ASE Group et Laurent Herard

Pourquoi certains grands groupes de l'industrie électronique en France, qui se targuent d'être innovants et déposent des centaines de brevets par an ne nous proposent-ils pas 2 ou 3 papiers ?

Du côté des OSAT, où étaient les concurrents d'ASE qui proposent habituellement des papiers ?

Et puis où étaient toutes ces start-ups innovantes de la région grenobloise dans les semiconducteurs ? Se rendent-elles au moins compte de la chance que nous avons d'avoir un tel

évènement à Grenoble et en France, et des bénéfiques qu'elles pourraient en retirer en termes d'échanges et de rayonnement ?

Mais ne blâmons pas ces entreprises et leurs représentants. C'est à nous, membres d'IMAPS, qu'il incombe de convaincre Thalès, Valeo, Safran, Soitec, UTAC, Amkor, JCET, Serma Microelectronics, Lynred, Wise Integration, Schneider Electric, Teledyne E2V, Kalray... de présenter des papiers l'année prochaine à MiNaPAD 2024, mais aussi de nous rejoindre au comité technique et au bureau IMAPS, que nous souhaitons plus représentatif de notre écosystème, et plus représentatif aussi en termes de genre : car nous n'avons aujourd'hui qu'une seule femme au bureau IMAPS, merci Sanae.



Sanae Boulay, Jean-Marc Yannou, Laurent Herard

Une grande partie de notre association passe par et pour MiNaPAD, notre grand évènement annuel. Charge à nous de définir nos ambitions. Nous pourrions, en tant que **l'un des chapitres IMAPS, les plus actifs en Europe**, depuis deux décennies, devenir un levier d'influence puissant auprès des autorités publiques, fussent-elles nationales ou européennes. Cela servirait d'autant mieux notre industrie, nos savoir-faire et nos emplois. Nous pourrions conseiller les décideurs alors qu'il est maintenant question de relocalisation des productions et d'aides publiques conséquentes.

Vos énergies et celles de ceux et celles que vous convaincrez de nous rejoindre dans cet objectif sont cruciales. S'il fait peu de doute qu'une vision de type « verre à moitié plein » désignera **MiNaPAD 2024** comme un nouveau succès, tout reste à écrire concernant l'autre moitié du verre.

Alors rejoignez-nous au bureau IMAPS, mais aussi invitez d'autres à nous rejoindre, afin de nous enrichir de vos et de leurs idées et énergies, et bâtissons ensemble une association professionnelle plus puissante au service de l'industrie des semiconducteurs et de l'électronique en France et en Europe.

Enfin, et pour conclure, nous avons noté de nombreuses questions de l'auditoire concernant **l'impact environnemental de notre industrie**. Le recyclage et la réparabilité des produits que nous fabriquons semblent être des questions fondamentales pour nombre de nos auditeurs, à l'heure où la perte de biodiversité et le changement climatique sont si rapides qu'ils en deviennent très visibles à l'échelle de nos courtes vies. Peut-être est-ce là aussi l'occasion de positionner notre événement avec différenciation ?

Devrions nous dédier **une session technique ou une table ronde sur le sujet lors de notre prochaine édition** ? Ici aussi, vos initiatives sont encouragées. Nous mettrons l'outil « IMAPS France » dans les mains de quiconque souhaite s'emparer de tels sujets et en faire un tremplin pour notre industrie au service de la société.

Cordialement

Jean-Marc YANNOU

Nous en profitons pour remercier Reynald DeRoche et Nicole Salvat pour leur indéfectible participation à l'organisation des événements IMAPS



Nicole et Reynald durant le dîner de Gala avec un gâteau surprise pour l'anniversaire de Reynald.

En aparté de MiNaPAD 2023 mais en lien avec les actions Régionales, Nationale et Européennes en cours de déploiement, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien : <https://youtu.be/xdrGnRnO1S0>



Un film pour la filière microélectronique

Présentation du film "La microélectronique en quête de talents", un film de Cyril Morat, réalisé pour le compte de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de l'Isère, en partenariat avec l'Agence Grenoble Alpes. A travers la présentation de quatre parcours professionnels, le film a l'ambition d'informer et d'attirer les candidats sur les métiers de la filière, mais aussi de mettre en valeur les atouts et la qualité de vie d'un territoire unique, l'Isère.

Cette vidéo est simple et efficace sur la microélectronique en quête de talent réalisée par la Métropole Grenoble – Alpes.

Alexandre VAL

IMAPS France

14^{ème} Forum Power 2023
From Nano to Macro Power
Electronics & Packaging Workshop
30 Novembre 2023
Greman, Université de Tours (37)



Comité technique

Chairman :

Laurent BARREAU (ST Microelectronics Tours)

Co-chairman :

Daniel ALQUIER (GREMAN Laboratory)

Franck DOSSEUL (MODULEUS)

Membres :

Stephane BELLENGER (ST Microelectronics Grenoble)

Lars BOETTCHER (FRAUNHOFER Institute)

Cyril BUTTAY (AMPERE Laboratory)

Guillaume CALLERANT (SONCEBOZ)

Jean-Luc DIOT (PRIVATE)

Guo-Quan LU (VIRGINIA TECH)

Les appels à résumés sont en cours, avec une couverture nationale, européenne et internationale, comptabilisant plus de 2000 adresses électroniques. Mais le succès de ces appels provient aussi de vos réseaux respectifs, n'hésitez donc pas à relayer l'information !

Pour rappel concernant le contenu de l'appel à papiers :

- power management for industrial and transportation systems
- Energy harvesting systems, from nano to macro (smart grid, wind energy, photovoltaic,)
- Energy conversion systems: from power to emission (lighting, ultrasonic, infrared,..)

These topics could be developed around several themes, such as:

- New materials and substrates dedicated to power electronics
- Thermal or thermos-mechanical or regulatory constraints (RoHS regulation, REACH,..)
- Dedicated technologies for integration and optimization of power systems, including passive components (weight and size reduction, yield improvement, efficiency, ...)
- Innovative technologies, materials and processes dedicated to interconnection and packaging (die attach materials, bonding and ribbon wires, 3D power components,..)
- Reliability and failure modes (impacts linked to technologies, thermal constraints, etc..), predictive methods, design of experiment,..
- High current and high voltage or extremely high voltage: impact on packaging technologies

Nous avons à ce jour pris un peu de retard et n'avons reçu que peu de papiers, mais nous avons activé nos réseaux pour étoffer autant que possible le nombre de papiers reçus avant les vacances d'été.

Vous trouverez toutes les informations sur le site dédié :

[POWER 2023 – IMAPS France \(imapseurope.org\)](http://imapseurope.org)

Dates clés POWER 2023

Commercialisation des stands : Avril 2023

Ouverture de l'appel aux résumés : Avril 2023

Sélection des papiers : Septembre 2023

Notification des orateurs : fin Septembre 2023

Programme : Début Octobre 2023

Cordialement,

L'équipe de POWER 2023

17th European ATW on Micropackaging and Thermal Management

31 janvier -1^{er} février 2024
Mercure La Rochelle



Événement sponsorisé par :



Co-chairmen :

Bruno LEVRIER (BL Expertise)
Jean-Pierre FRADIN (ICAM Toulouse)
Jean-Yves SOULIER (Safran Data Systems)

En revenant à La Rochelle et en planifiant le prochain et dix-septième workshop thermique fin janvier 2024 après avoir achevé le seizième en mars dernier, une impression de mouvement perpétuel habite le comité organisateur qui, à la veille des vacances d'été, aura quasiment bouclé la logistique de l'événement et reçu **deux inscriptions pour les stands** (merci à SERMA Technologies et à ACCELONIX) pour se concentrer désormais sur le programme des conférences.

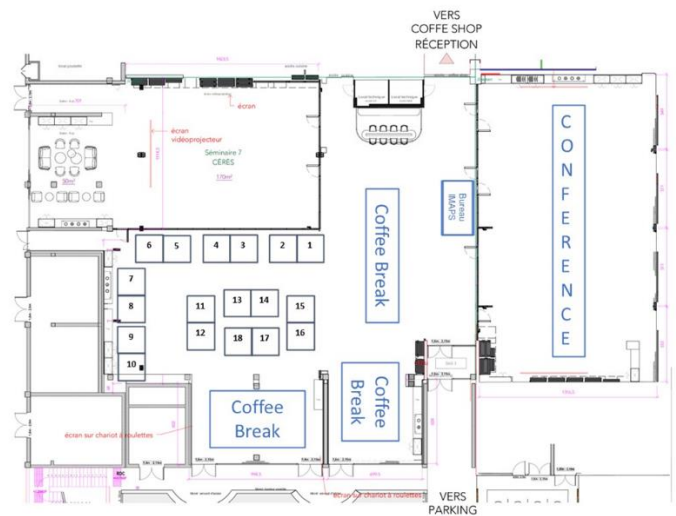
Après un premier résumé reçu ainsi qu'une dizaine de promesses à transformer elles aussi par des résumés, il ne nous restera plus qu'à glaner une douzaine de conférences supplémentaires nécessaire au bouclage d'un programme fin novembre début décembre. Les sessions techniques s'organiseront autour des thèmes habituels, solutions de refroidissement diphasiques, solutions de refroidissement du composant au système, matériaux innovants, simulations, méthodes de caractérisation et d'essai, innovations dans le management thermique.

Nous restons aussi intéressés par des visions globales et prospectives (véhicule électrique, avion plus électrique) permettant de synthétiser tout ce qui aura été développé dans les autres sessions.

Des conférences dans des domaines particuliers (tenue au feu ; batteries) auront également toute leur place dans notre workshop.

Comptant que cette coupure de l'été amène l'inspiration à de nombreux conférenciers, nous souhaitons à tous de bonnes vacances.

Pour nos exposants, un nouvel agencement des 18 stands est proposé comme le montre le schéma ci-dessous :



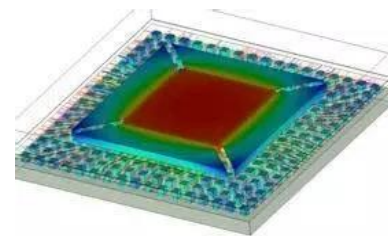
N'hésitez à réserver votre stand ou bien à vous positionner en option.

Les échanges entre participants et exposants restent identiques aux précédentes éditions Rochelaise.

Dates clés THERMAL 2024

Commercialisation des stands : Juin 2023
Ouverture de l'appel aux résumés : Mai 2023
Sélection des papiers : Octobre 2023
Notification des orateurs : Novembre 2023
Programme : Fin Novembre 2023

Jean-Yves Soulier



JOURNEE TECHNIQUE

Simulation Multi-échelle et Multi-physique

Objectif : Réunir les acteurs français et partager nos innovations et nos besoins pour répondre aux enjeux de la simulation de demain

Thématiques

Amélioration des performances du Packaging

- Niveau composant (chip, substrat, molding)
- Niveau carte
- Niveau équipement

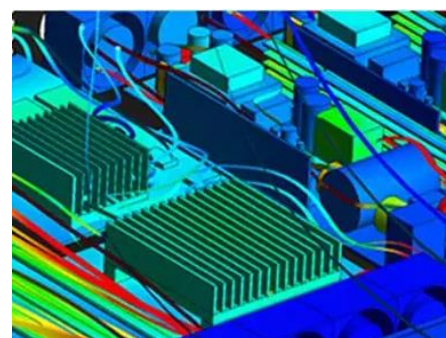
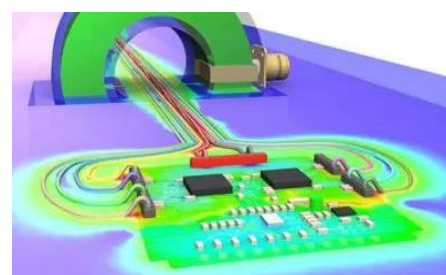
Multi-physique, multi-échelle, Multi-domaine

- RF, Thermal Management, EMC, ...

Design & Simulation

- Techniques d'optimisation multicritères
- Digital Twins et Prototypage virtuel

Caractérisation et modélisation de matériaux



Appel à contributions pour la journée

Format : Présentation de 20 minutes

Sélection : Résumé de 300 mots max. à envoyer avant le 22/09/2023 (cyril.buttay@insa-lyon.fr)

Comité scientifique :

- Cyril BUTTAY (Labo. Ampère/CNRS)
- Bradford FACTOR (ASE Europe)
- Wilson MAIA (Thales)
- Franck MEUNIER (Ansys)
- Fabien PARRAIN (C2N / Univ. Paris-Saclay, CNRS)
- Jean-Charles SOURIAU (CEA-Leti)
- Alexandre VAL (Valeo)

Sponsors :



9h30 à 16h30

C2N : Paris Saclay
10 Boulevard Thomas Gobert
91120 Palaiseau

Mardi

**5 Décembre
2023**

Participation gratuite, sur inscription

Contacteur : Cyril BUTTAY cyril.buttay@insa-lyon.fr

COMMUNICATION

Le Groupe SERMA annonce la nomination d'un Directeur Général

Pessac, 1^{er} juin 2023 – Le Groupe SERMA, expert français de la fiabilisation et de la sécurisation des systèmes électroniques, des systèmes de puissance et des systèmes d'information, est fier d'annoncer l'arrivée de M. Pierre-Olivier BESOMBES en tant que Directeur Général du Groupe SERMA.

Cette nomination stratégique marque une étape importante dans l'évolution et la structuration du Groupe SERMA.

Compte-tenu de la taille croissante du Groupe SERMA (1300 collaborateurs et 170 millions de chiffre d'affaires en 2022), de la multiplication de ses métiers stratégiques, de son développement à l'international et de la nécessité de garantir sa pérennité, Philippe BERLIE a décidé de renforcer la gouvernance du Groupe SERMA.

Pierre-Olivier BESOMBES apporte une expertise complémentaire, une vision novatrice et une passion pour l'innovation, qui s'alignent parfaitement avec la culture d'entreprise et les valeurs du Groupe SERMA.

Avant de rejoindre SERMA, Pierre-Olivier BESOMBES a occupé des postes de direction de haut niveau au sein de plusieurs entreprises industrielles en France et à l'international qui lui permettront de diriger efficacement le Groupe SERMA dans un environnement en constante évolution.

En tant que leader accompli, il saura accélérer la croissance déjà forte du Groupe pour l'amener au statut de partenaire international incontournable pour les acteurs industriels de l'électronique, l'énergie, la sécurité et les télécommunications.

Le Groupe SERMA est piloté depuis 2007 par Philippe BERLIE, actuel PDG du Groupe. La séparation des fonctions de Président et de Directeur Général donnera au Groupe une plus grande agilité tout en préservant la proximité existante avec les clients et les équipes.

En tant que Directeur Général, Pierre-Olivier BESOMBES aura la responsabilité du périmètre et de la performance opérationnelle du Groupe.

Philippe BERLIE, Président Directeur Général du Groupe SERMA depuis plus de 15 ans, se consacrera quant à lui à la fonction de Président du Groupe ; il portera la relation avec les actionnaires, la vision et le développement stratégiques ainsi que les actions structurelles servant la croissance et la création de valeur du Groupe SERMA.

« Rejoindre le Groupe SERMA en tant que Directeur Général est un véritable honneur pour moi. La réputation inégalée de SERMA, ses valeurs fortes ancrées dans l'excellence et son expertise remarquable en font un acteur clé de l'industrie. Je suis ravi de collaborer avec une équipe exceptionnelle, animée par la passion et le dévouement, afin de consolider notre position de leader sur le marché tout en continuant à innover et à repousser les limites de l'excellence technique. Avec le soutien inestimable du fondateur et Président de SERMA, Philippe BERLIE, et notre engagement collectif, je suis convaincu que nous atteindrons de nouveaux sommets et que nous écrivons un nouveau chapitre passionnant de l'histoire de SERMA, tout en fournissant des solutions et des services de pointe à nos clients. »

Pierre-Olivier BESOMBES, Directeur Général du Groupe SERMA

« Je suis heureux de la confiance accordée par Pierre-Olivier. Avec à son expérience, je suis convaincu que nous allons amener le Groupe SERMA au plus haut et repousser nos limites en France et à l'international. J'apporterai à Pierre-Olivier toute mon aide pour réussir cette étape et relever ces nouveaux défis. »

Philippe BERLIE, Président du Groupe SERMA

BULLETIN D'ADHESION 2023

- 100 € pour les membres individuels en activité.
- 50 € pour les membres retraités.
- 20 € pour les membres privés d'emploi, étudiants
- 650 €*HT Adhésion Société

Date Signature

Mme Mr Numéro AdhérentA020.....

NomPrénom.....

Société

Fonction

Adresse

Code Postal Ville Pays

Tel Email

Adhésion Individuelle :

- Tarif réduit sur tous les événements IMAPS (Europe, Etats-Unis), journée technique, salon MiNaPAD, workshops, salons européens EMPC
- Tarif réduit sur toutes les publications achetées à l'IMAPS.
- Accès à tous les espaces « Members Only » du site web IMAPS et à la base de données « Proceedings »
- Droit de vote pour les élections IMAPS.

Adhésion Société :

- *Tarif IMAPS membres pour tout représentant de votre société pour les conférences organisées par IMAPS France.
- 6 personnes de votre société identifiées comme membre IMAPS individuel reçoivent l'ensemble des publications d'IMAPS
- Accès illimité à l'Espace membres et à la base de données « Proceedings »
- Droit de vote aux Assemblées générales (6 voix).

Inscription et paiement en ligne: www.france.imapseurope.org

MODALITES DE REGLEMENT

Carte bleue

Virement bancaire : Crédit Lyonnais Agence Versailles Saint Louis IBAN FR 49 3000 2089 4800 0007 9088 G25. BIC : CRLYFRPP

Chèque à l'ordre de IMAPS- France, accompagnant le bulletin d'adhésion.

Adresse postale pour l'envoi de chèque :

IMAPS France
A l'attention de monsieur Jean-Yves SOULIER
66, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris

Une facture vous sera adressée. La cotisation société est déductible des impôts de votre société (versement à une association).